

## 深圳市唯特偶新材料股份有限公司

### 关于对深圳证券交易所关注函回复的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 特别风险提示：

- 1、截至 2026 年 6 月 5 日，根据中证指数有限公司的最新数据显示，深圳市唯特偶新材料股份有限公司（以下简称“公司”）最新滚动市盈率为 249.18 倍，显著高于所属中上协行业分类“C39 计算机、通信和其他电子设备制造业”对应的行业最新滚动市盈率 63.84 倍，公司提醒广大投资者注意风险，审慎决策、理性投资；
- 2、公司微电子焊接材料的客户及应用行业较为分散，单一客户业绩变动不会对公司整体经营成果产生重大影响，具有“小产品、大市场”的特点，敬请广大投资者理性决策，注意投资风险；
- 3、光模块、先进封装等业务市场需求和发展前景尚存在不确定性，且截至目前，公司在光模块及先进封装领域的营收占比贡献率较低，均不到 1%，预计短期内不会对公司经营业绩产生重大影响。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险；
- 4、公司股价短期上涨幅度较大，可能存在市场情绪过热和非理性炒作的情形，随时存在快速下跌的风险，敬请广大投资者理性决策，注意投资风险。

深圳市唯特偶新材料股份有限公司于 2026 年 6 月 4 日收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）创业板公司管理部下发的《关于对深圳市唯特偶新材料小产品、股份有限公司的关注函》（创业板关注函〔2026〕第 11 号，以下简称“关注函”），要求公司就所提问题做出书面说明并对外披露，同时抄送深圳证

监局上市公司监管处。公司收到关注函后高度重视，立即组织相关部门对涉及的相关问题逐项进行认真核查与落实，现将有关情况回复如下：

**问题 1**

**1.你公司主营业务为微电子焊接材料的研发、生产及销售。请你公司：**

**（1）说明公司所属行业当前竞争格局、资金及技术进入壁垒，公司在竞争中具有优劣势情况；结合公司最近一年一期经营情况，主要财务数据及其变动趋势、原因，主营产品目前销售领域、主要客户构成、所属领域、销售金额、毛利情况，与同行业可比公司是否存在显著差异。**

**【公司回复】**

**1、行业竞争格局及公司优势**

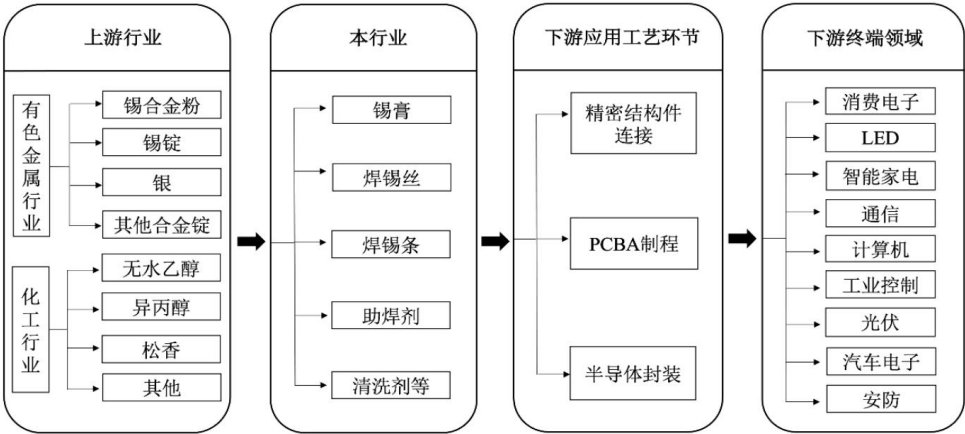
**(1)公司及行业情况**

公司系国家级高新技术企业，深耕电子新材料领域，集研发、生产、销售于一体，核心聚焦电子装联材料，主要产品包括以锡膏、锡条、锡丝为代表的微电子焊接材料，占比 88.61%，以及以助焊剂、清洗剂、稀释剂为代表的微电子辅助焊接材料。根据《国民经济行业分类》（GB/T4754—2017），公司所处行业为“计算机、通信和其他电子设备制造业”，分类代码为 C39。



公司生产的微电子焊接材料作为电子材料行业的重要基础材料之一，主要应用于 PCBA 制程、精密结构件连接、半导体封装等多个产业环节的电子器件的

组装与互联环节，最终广泛应用于消费电子、显示与照明、智能家电、通信、计算机、工业控制、光伏、半导体、汽车电子、安防等多个行业。公司客户及行业较为分散，单一客户业绩变动不会对公司整体经营成果产生重大影响，具有“小产品、大市场”的特点。微电子焊接材料的产业链具体如下图所示：



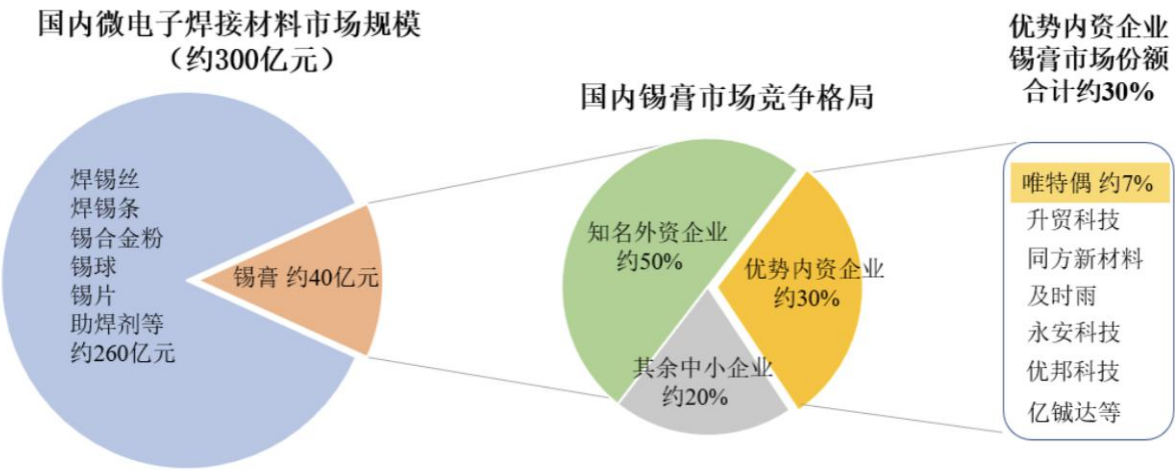
## （2）竞争格局

国内电子焊接材料行业整体呈现“外资领跑、内资追赶”的竞争格局：欧美系、日系外资厂商依托深耕行业多年的技术积淀、高额研发投入与成熟产品体系，在国内高端锡膏市场占据主导地位；本土内资企业则凭借地缘优势、本地化快速配套与高效客诉响应能力，稳固国内中低端市场份额，持续向高端领域追赶突破。

公司是国内微电子焊接材料的领先企业之一，特别是在锡膏和助焊剂两个细分领域行业地位突出。公司是中国电子材料行业协会理事单位、中国电子材料行业协会电子锡焊料材料分会副理事长单位。在中国电子材料行业协会举办的第二届（2017 年）及第三届（2019 年）中国电子材料行业专业十强企业评选活动中，唯特偶均位列“电子锡焊料专业十强”第二名。根据中国电子材料行业协会电子锡焊料材料分会出版的《锡焊料》月刊及出具的《证明》，2019 年锡膏出货量全球前三强企业为美国爱法、日本千住和中国唯特偶；公司 2019 年至 2021 年连续三年锡膏产销量/出货量国内排名第一。

从国内整体市场来看，2020 年我国微电子焊接材料行业总体规模约为 300 亿元，以公司 2020 年 5.9 亿元的营业收入来测算，占国内微电子焊接材料市场 2%左右的份额，未来增长空间巨大。以锡膏为例，国内的销售规模为 40 亿元左

右，公司 2020 年锡膏销售收入 2.63 亿元，公司锡膏产品销售规模仅占国内锡膏市场的 7%左右。具体情况如下图所示：



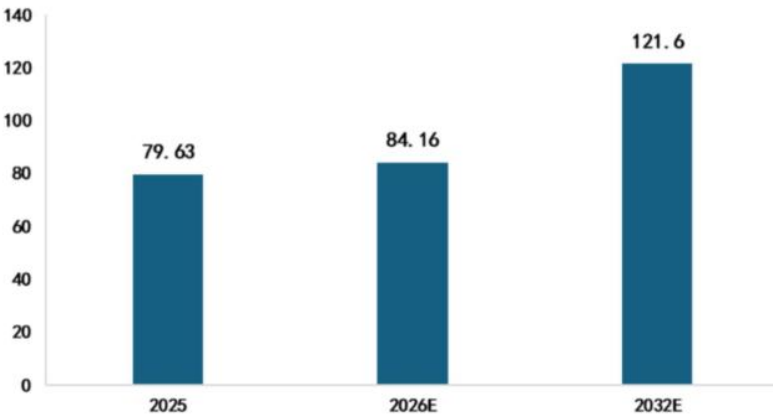
根据中国电子材料行业协会电子锡焊料材料分会统计数据，2024 年本土代表性企业唯特偶、同方新材等合计占据了约 31%的市场份额。

2025 年公司整体营业收入达 15.04 亿元，2025 年锡膏产品营业收入达 6.47 亿元。

根据 QYResearch 分析报告，2025 年全球电子级锡焊料市场规模约为 79.63 亿美元，预计至 2032 年将达到 121.6 亿美元，2026—2032 年复合增长率约为 6.3%；其中，中国作为全球最大的市场，约占 61%的市场份额。

2025 年、2026 年、2032 年全球电子级锡焊料市场规模及预测

单位：亿美元



数据来源：QY Research

### **（3）公司的优势**

#### **优势 1：综合实力突出，行业地位稳固**

国内微电子焊接材料行业企业数量众多、规模参差不齐，多数中小企业研发与技术水平偏弱。公司凭借持续的技术创新投入、成熟的生产工艺及稳定优质的产品供给，在行业竞争中逐步构建起显著的差异化竞争优势，核心市场地位持续巩固。公司累计主导及参与制修订国家标准 20 项、行业标准 12 项，拥有授权专利 36 项（其中发明专利 33 项），形成了坚实的技术壁垒与较强的行业引领能力，充分彰显了行业引领地位与深厚技术积累。

#### **优势 2：研发实力强劲，筑牢技术壁垒**

自成立以来，公司始终坚守“研发一代、应用一代、储备一代”的滚动式研发战略，持续积淀核心研发实力，先后获评国家高新技术企业、国家专精特新“小巨人”企业，斩获多项重量级荣誉，研发硬实力获行业认可；公司深化产学研协同合作，加大研发投入、强化人才梯队建设，持续引进多名高端研发人才，同时引进高端测试设备升级硬件支撑体系。经过多年深耕细研，公司在超细粒度焊接材料、低温高可靠焊接材料、光伏组件焊接材料、辅助焊接材料及水基清洗剂等关键技术领域实现了突破，成功打破了技术瓶颈，缩小了与国际领先企业的技术差距，在微电子焊接材料及辅助焊接材料领域构建起坚固的技术护城河。

#### **优势 3：优质客户集聚，前瞻布局市场**

公司长期深耕消费电子、通信、显示与照明、汽车电子等战略性新兴产业，依托稳定优异的产品性能、专业高效的技术服务及完善的质量管控体系，成功构建以行业龙头为核心的优质客户体系。凭借优质客户资源形成的良好市场声誉与协同效应，公司在巩固与核心客户战略合作关系的同时，积极拓展新兴客户、优化客户结构与产品组合，坚持以市场需求为导向，与客户联合开展前瞻性技术研发与产品创新，提供高附加值产品及系统性解决方案。双方深度互信与协同创新机制，使公司能精准研判产业趋势、提前布局关键技术与市场机遇，为经营稳定及可持续增长奠定坚实基础。

### **2、资金及技术壁垒**

国内焊锡行业竞争存在资金及技术壁垒，具体情况如下：

### （1）资金壁垒

资金壁垒是限制本行业公司发展壮大的重要壁垒之一。在软硬件配置方面，业内企业需要耗用大量的资金配备先进的研发检测设备以及建设具有合规资质的厂房等；另一方面，由于客户数量多，产品需求多样化，为确保及时快速交付，业内企业一般需备货生产，而主要原材料锡锭、锡合金粉等金属材料又需占用大量流动资金；此外，在客户认证、新产品研发过程中也需大量资金支持，资金实力不足的企业很难满足客户的多样化需求。因此本行业存在明显的资金壁垒。

### （2）技术壁垒

微电子焊接材料行业属于技术密集型行业，涉及材料、物理、化学、机械、电子、自动控制等多个学科的交叉综合应用，而成熟的产品配方体系往往需要多年的积累，并且随着下游行业的快速发展，势必要求微电子焊接材料更新换代速度不断加快，这对企业研发技术人员的综合性学科知识提出了较高要求。同时随着电子装联行业的新技术、新工艺不断涌现，产品和工艺更新迭代加快，这就要求行业企业必须不断提升技术创新能力、装备水平、工艺水平和精益生产水平，因此本行业具有较为明显的技术壁垒。

## 3、公司竞争劣势

### 劣势 1：发展周期较短，相较头部外资企业存在技术与营收规模差距

全球电子焊接材料行业经过百年发展，已形成较为完善的产业格局，市场化程度较高。从全球范围来看，外资企业处于相对领先地位，美国爱法（成立于 1872 年）、日本千住（成立于 1938 年）等国际企业起步较早，技术水平和生产能力均处于世界领先地位，且主导高端产品市场。国内电子焊接材料行业起步较晚，公司仅发展了二十余年，受发展周期制约，公司营收体量与国际头部外资企业仍存在差距。

### 劣势 2：发展积淀相对不足，较国际领先外资企业品牌力较弱

高端产品下游客户认证周期长、供应链准入门槛高，外资品牌凭借多年市场积淀构筑突出品牌壁垒，公司经营存续时间相对较短，品牌积淀薄弱，相较于国

际领先外资企业品牌力偏弱。

### **劣势 3：公司受制于上游原材料价格波动，成本和采购定价权较弱**

公司主要原材料为锡锭、锡合金粉等，前述原材料成本占主营业务成本比重较高。其中，锡锭价格主要受国际国内锡金属市场行情影响，锡合金粉价格受锡、银等贵金属价格共同驱动。相较于拥有上游锡矿产业链的同行，公司原材料采购议价与成本抵御能力较弱。公司产品定价虽与主要原材料价格存在一定联动机制，但价格传导在时间与幅度上存在滞后性，原材料价格大幅波动将直接影响公司生产成本与盈利水平。若主要原材料价格持续或短期内大幅上涨，而产品价格未能及时同步调整，公司将面临毛利率下滑、经营业绩波动的风险。

### **4、公司最近一年一期经营情况，主要财务数据及其变动趋势、原因**

2025 年，公司实现营业收入 15.04 亿元，同比增长 24.07%；在收入稳步增长的同时，毛利润同比增加 1,560.49 万元，增长率达 7.27%；归母净利润约 7,879.32 万元，同比下降 11.82%；扣非归母净利润约 6,799.39 万元，同比下降 11.49%。报告期内公司业绩出现波动，主要原因是产品销量增长、原材料价格上涨拉动收入和毛利润增长，战略投入持续加大、价格传导具有一定滞后性和非经常性损益贡献下降导致归母净利润和扣非归母净利润同比下降。

2026 年第一季度公司实现营业收入 3.94 亿元，同比增长 27.44%；归母净利润约 2,975.32 万元，同比增长 36.72%；扣非净利润 2,864.84 万元，同比增长 46.24%。公司 2026 年一季度业绩实现显著改善，核心原因在于定价模式的优化。面对原材料价格上涨，公司价格传导相对及时，毛利率回升至 17.71%，较去年同期提升 1.45 个百分点。

### **5、同行业可比公司具体情况对比**

目前国内A股市场并无与公司主营业务完全一致的上市公司。现将锡业股份、华光新材、优邦科技、晨日科技四家企业作为可比公司，主要是因为上述公司生产销售的产品与本公司产品有一定的重叠和关联性；另一方面上述可比公司均已在资本市场上市、拟上市或挂牌，有公开披露的数据。

但上述可比公司在经营规模、产品种类结构、主要客户构成及其应用领域等

方面与公司仍存在较为明显的差异，主要财务数据及其变动与公司也存在较为明显的差异。公司主要财务数据及其变动趋势与同行业可比公司对比情况如下：

| 公司名称 | 2025 年营业收入（万元） | 2025 年毛利率 | 2025 年收入同比增长率 | 2026 年 Q1 营业收入（万元） | 2026 年 Q1 毛利率 | 2026 年 Q1 收入同比增长率 | 主要产品                    | 主要客户构成                                                               | 应用领域                                        |
|------|----------------|-----------|---------------|--------------------|---------------|-------------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| 唯特偶  | 150,379.06     | 15.31%    | 24.07 %       | 39,436.22          | 17.71 %       | 27.44 %           | 锡膏、锡丝、锡条、助焊剂、清洗剂等       | 冠捷科技、中兴通讯、富士康、奥海科技、海尔集团、格力电器、华为、TCL 通讯、比亚迪、艾比森、立讯精密、公牛集团、海康威视、大疆等    | 通讯、显示与照明、家电、光伏、汽车电子、消费电子、电源、安防及半导体等         |
| 锡业股份 | 4,353,458.09   | 11.37%    | 3.72%         | 1,555,186.29       | 10.04 %       | 59.86 %           | 锡锭、铜产品、供应链业务、其他产品等      | 未公开披露                                                                | 电子、光伏电池、电动汽车、AI 芯片、食品包装及航空航天等领域             |
| 华光新材 | 255,588.51     | 12.93%    | 33.27 %       | 107,865.86         | 12.08 %       | 84.11 %           | 银钎料、铜基钎料、银浆、其他材料等       | 美的集团、格力电器、海尔集团、开利、奥克斯、海信集团、东芝、格兰仕、三花智控、丹佛斯、大金、TDK、伊莱克斯、三菱电机、松下万宝、海立等 | 智能家居、能源电力、轨道交通、新能源汽车、工业刀具、电子半导体、航空航天、AI 液冷等 |
| 优邦科技 | 113,568.72     | 27.33%    | 10.84 %       | 未公开披露              | 未公开披露         | 未公开披露             | 电子胶黏剂、电子焊接材料、湿化学品、自动化设备 | 富士康、台达集团、和硕集团、群光电能、奇宏科技、明纬电子、立讯精密、亿纬锂能等                              | 智能终端、通信、新能源、半导体等                            |
| 晨日科技 | 12,250.02      | 24.00%    | 6.25%         | 未公开披露              | 未公开披露         | 未公开披露             | 常规锡膏、高温锡膏、胶类产品、其他产品     | 重庆平伟实业股份有限公司、广东洲明节能科技有限公司、泗洪红芯半导体有限公司、杭                              | 半导体封装、集成电路封装、LED 封装等                        |

|     |              |        |        |            |        |        |   |                          |   |
|-----|--------------|--------|--------|------------|--------|--------|---|--------------------------|---|
|     |              |        |        |            |        |        |   | 州乔泰电子有限公司、东莞市吉田焊接材料有限公司等 |   |
| 平均值 | 1,183,716.34 | 18.91% | 13.52% | 831,526.07 | 11.06% | 71.99% | - | -                        | - |

注：截至本问询回复出具日，同行业可比公司优邦科技和晨日科技尚未披露 2026 年 1 季度数据。

从产业链布局及主营业务划分来看，锡业股份主要产品是锡锭，属于本公司所在行业上游企业，是本公司的主要供应商之一；华光新材聚焦高温硬钎焊材料研发生产，主要产品为银钎料、铜基钎料；唯特偶主营业务锡膏产品属于低温软钎焊料；优邦科技主营业务为电子胶黏剂及电子焊接材料，产品结构与公司差异较大；晨日科技主营软钎焊锡膏产品，业务结构、下游应用领域与本公司相似。

（2）说明截至目前公司主营产品微电子焊接材料与微电子辅助焊接材料（锡膏、锡条、锡线、助焊剂、清洗剂等）主要直接及间接客户、产能及产能利用率、月度产销量、月度销售额、在手订单、具体用途等情况，是否较前期披露信息发生较大变化，相关变化对公司经营业绩产生的具体影响，并充分提示相关风险。

**【公司回复】**

目前本公司主营产品微电子焊接材料与微电子辅助焊接材料（锡膏、锡条、锡线、助焊剂、清洗剂等）主要直接及间接客户较前期披露信息未发生较大变化，系公司客户比较分散，分布在多个行业，公司 2025 年前十大客户收入占比 27.47%，这部分客户在 2026 年一季度收入占比为 29.52%，未发生较大变化。其中个别客户收入和占比存在上升或下降，具体情况如下：

| 序号 | 2025 年合并前十大客户 | 2025 年收入（元）   | 占比    | 2026 年 Q1 收入（元） | 占比     |
|----|---------------|---------------|-------|-----------------|--------|
| 1  | 客户一           | 84,977,308.25 | 5.65% | 4,788,716.29    | 1.21%  |
| 2  | 客户二           | 69,365,068.33 | 4.61% | 43,945,668.56   | 11.14% |
| 3  | 客户三           | 45,096,222.13 | 3.00% | 18,991,545.71   | 4.82%  |
| 4  | 客户四           | 43,939,143.63 | 2.92% | 8,739,568.33    | 2.22%  |

| 序号 | 2025 年合并前十大客户 | 2025 年收入<br>(元) | 占比     | 2026 年 Q1 收入<br>(元) | 占比     |
|----|---------------|-----------------|--------|---------------------|--------|
| 5  | 客户五           | 35,396,138.25   | 2.35%  | 5,686,220.77        | 1.44%  |
| 6  | 客户六           | 30,132,770.09   | 2.00%  | 9,281,406.01        | 2.35%  |
| 7  | 客户七           | 28,363,499.70   | 1.89%  | 4,448,811.90        | 1.13%  |
| 8  | 客户八           | 27,936,775.94   | 1.86%  | 12,862,287.24       | 3.26%  |
| 9  | 客户九           | 26,939,989.30   | 1.79%  | 2,544,949.11        | 0.65%  |
| 10 | 客户十           | 20,921,334.14   | 1.39%  | 5,116,672.37        | 1.30%  |
| 合计 |               | 413,068,249.76  | 27.47% | 116,405,846.29      | 29.52% |

目前本公司主营产品产能情况较前期披露信息未发生较大变化,随着公司订单的持续增长,主营产品的产能利用率在大多数时间超过 100%,由于假期因素影响(例如 2 月春节假期订单较少)、客户订单月度差异导致产能利用率在月度之间会有所变动,总体月度产量和月度销量、月度销售额趋势基本保持一致。

公司最近一年一期内,各月产能及产能利用率、产销量及销售额情况及变动趋势如下:

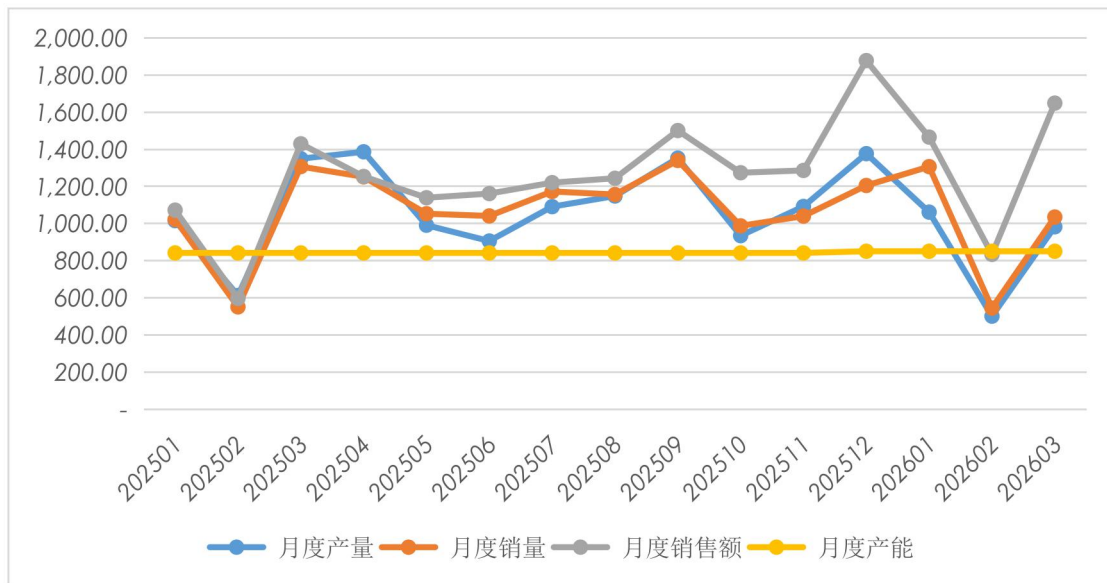
单位:吨、万元

| 月份    | 202501  | 202502 | 202503  | 202504  | 202505  | 202506  | 202507  |
|-------|---------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 产能    | 841     | 841    | 841     | 841     | 841     | 841     | 841     |
| 产能利用率 | 120.67% | 72.71% | 160.35% | 164.77% | 117.74% | 107.62% | 129.62% |
| 产量    | 1014    | 611    | 1348    | 1385    | 990     | 905     | 1090    |
| 销量    | 1021    | 550    | 1305    | 1250    | 1052    | 1040    | 1171    |
| 销售额   | 10708   | 5957   | 14280   | 12521   | 11377   | 11600   | 12189   |

接下表:

| 月份    | 202508  | 202509  | 202510  | 202511  | 202512  | 202601  | 202602 | 202603  |
|-------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|--------|---------|
| 产能    | 841     | 841     | 841     | 841     | 849     | 849     | 849    | 849     |
| 产能利用率 | 136.45% | 160.71% | 111.06% | 129.75% | 161.88% | 124.81% | 58.88% | 115.53% |
| 产量    | 1147    | 1351    | 933     | 1091    | 1375    | 1060    | 500    | 981     |
| 销量    | 1155    | 1338    | 986     | 1039    | 1204    | 1305    | 544    | 1034    |
| 销售额   | 12424   | 14993   | 12723   | 12846   | 18760   | 14641   | 8325   | 16471   |

单位：吨、十万元、吨/月



2026 年 5 月底，本公司在手订单金额为 5,085.05 万元。

目前本公司主营产品用途较前期披露信息未发生较大变化。具体用在 PCBA 制程、精密结构件连接、半导体封装等多个产业环节的电子器件的组装与互联，并最终广泛应用于消费电子、显示与照明、智能家电、通信、计算机、工业控制、光伏、半导体、汽车电子、安防等多个行业。

综上所述，公司目前情况与公司前期披露信息未发生较大变化。

公司服务的客户数量累计超过 4000 家，涵盖多个下游应用领域。客户及行业较为分散，不存在大客户集中依赖情形，单一客户业绩变动不会对公司整体经营成果产生重大影响。敬请投资者审慎对待，谨防热点概念型炒作，注意投资风险。

## 问题 2

2.你公司在上述期间内发布的 7 份投资者关系记录表中，6 份提及公司产品在光模块领域相关应用，称“在光模块及其部件的生产过程中，锡膏主要应用于三大环节：一是光器件的 SMT 贴装，二是光芯片封装中的高精度倒装焊，三是 PCBA 上其他无源元件的表面贴装。公司的微电子焊接材料等产品可应用于上述应用场景”。请你公司：

(1) 说明光模块生产商在光模块及其部件生产过程中各环节所需使用锡膏

的含量，对应单价及金额、占光模块产品价格的比例；

**【公司回复】**

光模块生产过程中，锡膏主要用在四个环节：PCB 主板SMT 、TOSA/ROSA 光器件与 COB 光引擎焊接、高速 FPC 软板热压焊接、结构件/壳体接地焊接。

各环节适配锡膏粒径不同：主板 SMT 主流用 T4-T6 锡膏，部分客户选用 T5-T6 超细粉锡膏，高速产品因 BGA 微焊点增多，因此锡膏消耗量有所增加；光器件及 COB、高速 FPC 焊接多使用 T5-T7 高端超细粉锡膏，800G/1.6T 产品 FPC工序进一步升级至 T6-T7 规格；结构件/壳体接地焊接则采用常规T4 锡膏，各速率产品均少量使用。

整体来看，低速光模块多使用常规锡膏、成本随锡银等原料价格浮动，高速率光模块受工艺限制，则需采用 T5-T7 超细粉锡膏。

①光模块不同工艺环节对应使用的锡膏牌号：

| 工艺环节                            | 锡膏牌号  | 典型焊盘                                      |
|---------------------------------|-------|-------------------------------------------|
| PCB 主板 SMT                      | T4-T6 | 阻容件 0201：0.3×0.15mm；QFN/BGA 按开孔面积         |
| TOSA/ROSA 光器件封装 / 主芯片 COB 光引擎焊接 | T5-T7 | TO 引脚 $\phi$ 0.3mm 圆形焊盘；COB 微焊盘 0.1~0.2mm |
| 高速 FPC 软板热压焊接                   | T5-T7 | 窄间距引脚 0.2~0.4mm 长条焊盘                      |
| 结构件 / 壳体接地焊接                    | T4    | 大焊盘 2~5mm                                 |

②不同速率的光模块对应焊点数量及锡膏用量等情况：

| 光模块速率 | 焊点数量 (个)  | 锡膏用量 (g) | 锡膏牌号  | 锡膏价格 (元/g) | 单个光模块锡膏成本金额 (元) | 光模块产品价格 (元) | 锡膏产品占光模块产品价格比例 |
|-------|-----------|----------|-------|------------|-----------------|-------------|----------------|
| 100G  | 600-700   | 0.2-0.3  | T4-T5 | 1.5-2.5    | 0.3-0.75        | 250-3000    | 0.025%-0.12%   |
| 400G  | 1000-1300 | 0.5-0.6  | T5-T6 | 2.5-10     | 1.25-6          | 1450-4000   | 0.086%-0.15%   |
| 800G  | 2200-2500 | 1.0-1.2  | T5-T7 | 2.5-30     | 2.5-36          | 2500-4800   | 0.10%-0.75%    |
| 1.6T  | 4000-5000 | 2.0-2.4  | T5-T7 | 2.5-30     | 5-72            | 6500-9500   | 0.077%-0.758%  |

以上数据为公司通过公开信息收集整理，实际情况可能存在偏差，敬请投资者审慎对待，谨防热点概念型炒作，注意投资风险。

以 1.6T 光模块为例：单个产品锡膏成本金额约为 5-72 元，金额较小；锡膏产品占光模块产品价格比例约为 0.077%-0.758%，占比极低。

（2）结合对问题 1 的答复，说明公司目前主营产品分别应用在光模块生产三大环节的具体情况，包括各环节对应的主要客户名称、最近一年及一期已实现的销售金额、毛利率、在手订单金额。

**【公司回复】**

在光模块生产环节中，公司主要产品可用于 PCB 主板 SMT 、TOSA/ROSA 光器件与 COB 光引擎焊接，主要客户为客户十三、客户三十四，主要产品为 T7 超细粉锡膏及半导体专用清洗剂，主要应用于 1.6T 的光模块领域。2025 年度的销售金额合计为 381,079.72 元，2026 年 1-5 月累计销售金额合计为 1,343,628.13 元。

截至目前，本公司对光模块生产环节相关客户已实现的销售金额、毛利率、在手订单金额情况如下：

单位：元



单位：元

| 客户名称  | 2025 年销售<br>金额 | 2025 年<br>毛利率 | 2026 年 Q1 销<br>售金额 | 2026 年 4-5 月<br>销售金额 | 2026 年 1-5 月<br>累计销售金额 | 2026 年<br>毛利率 | 在手订<br>单 |
|-------|----------------|---------------|--------------------|----------------------|------------------------|---------------|----------|
| 客户十三  | 340,199.72     | 73.06%        | 317,087.10         | 999,341.03           | 1,316,428.13           | 73.69%        | 1,056.96 |
| 客户三十四 | 40,880.00      | 71.98%        | 13,600.00          | 13,600.00            | 27,200.00              | 67.85%        | -        |
| 合计    | 381,079.72     | 72.94%        | 330,687.10         | 1,012,941.03         | 1,343,628.13           | 73.57%        | 1,056.96 |

公司在上市前，T5/T6 粒径锡膏、T6/T7 固晶锡膏、小间距超细粉锡膏等产品的研发已取得一定的技术成果，其中超细粒度锡膏已经通过客户十五认证，并开始小批量试产，并持续供货。客户十五（不含代工厂数据）2023 年、2024 年、2025 年及 2026 年 1-5 月销售收入分别是 59.90 万元、100.44 万元、165.49 万元和 190.96 万元。单个客户占公司整体营收比例较低，对公司经营不产生重大影响。

公司作为上游焊接材料供应商，主要基于客户的采购订单进行产品交付，客户在 SMT 贴装、倒装焊及 PCBA 组装等环节的复杂生产流程中使用的实际锡膏用量暂未获悉。因此，无法精确拆分各环节对应的具体客户名称、销售金额及毛利率。

### 问题 3

3.你公司在上述期间内发布的 7 份投资者关系记录表中，2 份提及公司产品在先进封装领域相关应用，称公司生产的微电子焊接材料“主要应用于 PCBA 制程、精密结构件连接、半导体封装等多个产业环节的电子器件的组装与互联”公司将“推进激光锡膏、超细粉锡膏等产品在先进半导体封装等新兴领域的渗透应用，为业务增长提供技术支撑”。请你公司：

（1）说明半导体封装过程中各环节所需使用锡膏的含量，对应单价及金额、占终端产品价格的比例；

#### 【公司回复】

公司主营锡膏产品主要应用于半导体封装五大应用领域，涵盖分立器件、通用集成电路、先进 BGA 及倒装芯片、光模块、功率半导体模块。单颗产品锡膏耗用核算以焊盘面积、钢网厚度、焊点数量等工艺参数为依据，经工艺反向测算得出理论使用量，结合量产损耗系数，最终核定产品实际领用重量。

| 序号 | 产品类型            | 单颗锡膏平均消耗量 (g) | 锡膏规格   | 单颗锡膏成本 (元) | 终端产品单价 (元) | 锡膏成本占终端产品价格比例 |
|----|-----------------|---------------|--------|------------|------------|---------------|
| 1  | 分立器件 (TO/SOT)   | 0.02-0.2      | T4     | 0.005-0.3  | 0.5-10     | 1.0-3.0%      |
| 2  | 通用 IC (QFN/QFP) | 0.04-0.9      | T5     | 0.04-2     | 5- 100     | 0.8-2.0%      |
| 3  | BGA / 倒装先进芯片    | 0.25-1.5      | T6     | 1.5-15     | 100-3000   | 0.5-1.5%      |
| 4  | 功率 IGBT 模块      | 1.0-3         | T4     | 0.12-4     | 8-5000     | 0.08-1.5%     |
| 5  | 100G 光模块        | 0.2-0.3       | T4 -T5 | 0.3-0.75   | 250-3000   | 0.025%-0.12%  |
|    | 400G 光模块        | 0.5-0.6       | T5-T6  | 1.25-6     | 1450-4000  | 0.086%-0.15%  |

|          |         |       |        |           |               |
|----------|---------|-------|--------|-----------|---------------|
| 800G 光模块 | 1.0-1.2 | T5-T7 | 2.5-36 | 2500-4800 | 0.10%-0.75%   |
| 1.6T 光模块 | 2.0-2.4 | T6-T7 | 5-72   | 6500-9500 | 0.077%-0.758% |

以上数据为公司通过公开信息收集整理，实际情况可能存在偏差，敬请投资者审慎对待，谨防热点概念型炒作，注意投资风险。

(2) 结合对问题 1 的答复，说明公司目前主营产品分别应用在先进封装各环节的具体情况，包括各环节对应的客户名称、最近一年及一期已实现的销售金额、毛利率、在手订单金额。

**【公司回复】**

公司生产的微电子焊接材料主要应用于 PCBA 制程、精密结构件连接、半导体封装等多个产业环节的电子器件的组装与互联。

最近一年及一期，本公司对先进封装各环节相关客户已实现的销售金额、毛利率及截至目前在手订单金额情况如下：

单位：元

| 公司名称  | 细分类别                            | 2025 年销售金额   | 2025 年毛利率 | 2026 年 Q1 销售金额 | 2026 年 Q1 毛利率 | 在手订单金额    |
|-------|---------------------------------|--------------|-----------|----------------|---------------|-----------|
| 客户三十五 | 模拟 IC、功率器件<br>(C3972/C3973)     | 3,917,651.36 | 24.66%    | 1,421,650.45   | 32.26%        |           |
| 客户三十六 | 功率分立器件 + 电源 IC<br>(C3972/C3973) | 1,661,398.24 | 17.18%    | 452,389.37     | 30.46%        |           |
| 客户三十七 | 分立器件、电源 IC 设计<br>(C3972/C3973)  | 1,064,884.99 | 11.71%    | 217,168.14     | 10.41%        |           |
| 客户三十八 | 存储 IC 设计 (C3973)                | 604,026.45   | 16.35%    | 243,805.32     | 36.52%        | 54,513.27 |

|       |                                                               |            |        |            |        |           |
|-------|---------------------------------------------------------------|------------|--------|------------|--------|-----------|
| 客户十五  | 自研数字 IC、模拟 IC、光芯片 (C3973/C3974)、光通信半导体芯片 (C3974)              | 590,435.61 | 63.05% | 366,195.12 | 71.60% |           |
| 客户三十九 | IC 设计 (C3973)                                                 | 564,419.38 | 27.64% | 28,668.13  | 58.48% |           |
| 客户四十  | 存储半导体 (C3973)                                                 | 315,398.23 | 15.66% | 179,929.20 | 28.40% |           |
| 客户四十一 | 功率 IC、分立器件 (C3972/C3973)                                      | 311,941.52 | 61.12% | 64,304.95  | 63.43% | 24,709.59 |
| 客户四十二 | 模拟 IC 设计 (C3973)                                              | 148,951.56 | 5.02%  | 138,300.88 | 1.88%  |           |
| 客户四十三 | 存储 IC (C3973)                                                 | 140,088.49 | 23.85% | 79,646.02  | 36.25% |           |
| 客户四十四 | 功率半导体分立器件 + 车规级 MCU / 电源 IC (C3972、C3973)、光电半导体、传感器芯片、车规功率半导体 | 129,375.26 | 11.75% | 57,064.19  | 1.06%  |           |
| 客户十一  | 集成电路封装测试 (C3972/C3973)                                        | 46,217.76  | 50.48% | 1,787.63   | -3.83% |           |
| 客户四十五 | IC 设计 (C3973)                                                 | 134,761.06 | 23.54% | 50,973.45  | 39.45% |           |
| 客户四十六 | 分立器件、MCU (C3972/C3973)                                        | 146,150.44 | 16.77% | 37,168.14  | 7.29%  |           |
| 客户四十七 | 电源 IC、分立器件 (C3972/C3973)                                      | 166,420.35 | 24.66% |            |        |           |

|       |                                   |            |        |           |        |  |
|-------|-----------------------------------|------------|--------|-----------|--------|--|
| 客户四十八 | 电源 IC、分立器件设计<br>(C3972/C3973)     | 144,601.77 | 20.87% |           |        |  |
| 客户四十九 | 分立器件、电源 IC<br>(C3972/C3973)       | 138,566.36 | 18.06% |           |        |  |
| 客户五十  | 集成电路设计、消费类 IC 制造<br>(C3973)       | 116,035.39 | 10.55% | 12,026.55 | 18.14% |  |
| 客户五十一 | MEMS 传感芯片<br>(C3972/C3973)        | 105,840.70 | 94.88% |           |        |  |
| 客户五十二 | 显示驱动 IC (C3973)                   | 104,911.49 | 17.00% |           |        |  |
| 客户五十三 | 存储半导体 (存储芯片/存储模组赛道) (C3973)       | 41,973.46  | 17.77% | 11,681.42 | 26.72% |  |
| 客户五十四 | 分立器件、电源 IC<br>(C3972/C3973)       | 41,831.87  | 20.40% |           |        |  |
| 客户五十五 | 功率半导体 (功率 IC、MOSFET, C3972/C3973) | 34,581.24  | 9.52%  |           |        |  |
| 客户五十六 | 模拟前端 IC、传感芯片 (C3973)              | 10,982.30  | 15.77% | 21,371.69 | 27.36% |  |
| 客户五十七 | 驱动 IC (C3973)                     |            |        | 32,317.90 | 6.06%  |  |
| 客户五十八 | 模拟 IC、小信号分立器件<br>(C3972/C3973)    | 14,168.15  | 22.13% | 8,969.02  | 26.15% |  |
| 客户五十九 | 集成电路封装测试                          | 17,400.00  | 50.12% |           |        |  |

|       |                                       |               |        |              |        |            |
|-------|---------------------------------------|---------------|--------|--------------|--------|------------|
|       | (C3973)                               |               |        |              |        |            |
| 客户六十  | 功率 IC、分立器件<br>(C3972/C3973)           | 16,141.59     | 12.48% |              |        |            |
| 客户六十一 | 存储半导体<br>(存储芯片/存储模组赛道) (C3973)        | 6,535.40      | 20.00% | 4,601.77     | 23.16% |            |
| 客户六十二 | MEMS 传感器芯片<br>(C3972/C3973)           | 11,047.43     | 8.28%  |              |        |            |
| 客户六十三 | 存储 / 电源 IC<br>(C3973)                 | 7,146.01      | 58.11% | 3,362.83     | 58.25% |            |
| 客户六十四 | 功率 IGBT 驱动 IC、功率分立器件<br>(C3972/C3973) | 10,176.99     | 72.71% |              |        | 81,415.93  |
| 客户六十五 | 传感芯片、功率分立器件<br>(C3972/C3973)          | 8,753.98      | 10.42% |              |        |            |
| 客户六十六 | 存储 IC 设计 (C3973)                      | 4,719.00      | 57.64% |              |        |            |
| 客户六十七 | IC 设计 (C3973)                         | 3,097.35      | 15.49% |              |        |            |
| 客户十二  | 集成电路封装测试<br>(C3973)                   | 1,756.02      | 35.35% |              |        |            |
| 客户六十八 | 电源 IC、分立器件<br>(C3972/C3973)           |               |        | 1,327.43     | 42.63% |            |
| 客户六十九 | 功率半导体 (IGBT/SiC ,<br>C3972/C3973)     | 743.36        | 73.07% |              |        |            |
| 合计    |                                       | 10,783,130.56 | 24.66% | 3,434,709.60 | 33.56% | 160,638.80 |

上述先进封装环节相关客户所用产品类型不一致，兼顾公司高中低端产品，故毛利率变动幅度较大。

公司作为上游焊接材料供应商，主要基于客户的采购订单进行产品交付，暂未获悉客户在精密结构件连接、半导体封装等环节中实际使用的锡膏用量。因此，公司难以精确拆分并披露各环节对应的具体客户名称、销售金额及毛利率。

#### 问题 4

4.你公司在上述期间内发布的 7 份投资者关系记录表中，2 份提及通讯、显示与照明、家电、光伏、汽车电子、消费电子等多家热点头部企业及多家国际知名终端品牌客户。请你公司说明最近一年一期你公司与通讯、显示与照明、家电、光伏、汽车电子、消费电子等多家热点头部企业及多家国际知名终端品牌客户交易金额及收入、毛利占比，相关头部企业对公司经营业绩的贡献。

#### 【公司回复】

最近一年一期公司与多家热点头部企业及终端品牌客户具体交易情况如下：

单位：元

| 行业      | 客户   | 2025 年收入      | 2025 年收入占比 | 2025 年毛利占比 | 2026 年 Q1 收入  | 2026 年 Q1 收入占比 | 2026 年 Q1 毛利占比 |
|---------|------|---------------|------------|------------|---------------|----------------|----------------|
| 通讯行业    | 客户十四 | 11,156,170.83 | 0.74%      | 3.34%      | 2,639,871.82  | 0.67%          | 1.91%          |
|         | 客户十五 | 1,654,922.81  | 0.11%      | 0.38%      | 778,319.52    | 0.20%          | 0.64%          |
|         | 客户十六 | 26,791,174.28 | 1.78%      | 3.07%      | 6,378,974.59  | 1.62%          | 3.49%          |
| 显示与照明行业 | 客户三  | 45,096,222.13 | 3.00%      | 2.01%      | 18,991,545.71 | 4.82%          | 2.06%          |
|         | 客户十七 | 9,841,161.57  | 0.65%      | 0.43%      | 2,405,245.65  | 0.61%          | 0.90%          |
|         | 客户十八 | 1,303,292.91  | 0.09%      | 0.10%      | 617,822.99    | 0.16%          | 0.16%          |
| 家电行业    | 客户十九 | 11,523,094.94 | 0.77%      | -0.05%     | 1,205,383.99  | 0.31%          | -0.01%         |
|         | 客户六  | 30,132,770.09 | 2.00%      | 2.46%      | 9,281,406.01  | 2.35%          | 1.52%          |

| 行业        | 客户    | 2025 年收入       | 2025 年收入占比 | 2025 年毛利占比 | 2026 年 Q1 收入   | 2026 年 Q1 收入占比 | 2026 年 Q1 毛利占比 |
|-----------|-------|----------------|------------|------------|----------------|----------------|----------------|
|           | 客户九   | 26,939,989.30  | 1.79%      | 1.45%      | 2,544,949.11   | 0.65%          | 0.40%          |
|           | 客户二十  | 1,651,294.46   | 0.11%      | 0.20%      | 662,703.70     | 0.17%          | 0.31%          |
| 光伏行业      | 客户二十一 | 8,148,850.09   | 0.54%      | 1.53%      | 1,321,416.02   | 0.34%          | 0.86%          |
|           | 客户二十二 | 8,257,802.51   | 0.55%      | 0.51%      | 62,159.30      | 0.02%          | 0.05%          |
|           | 客户一   | 84,977,308.25  | 5.65%      | 3.16%      | 4,788,716.29   | 1.21%          | -1.18%         |
| 汽车电子行业    | 客户二   | 69,365,068.33  | 4.61%      | 3.21%      | 43,945,668.56  | 11.14%         | 7.62%          |
|           | 客户二十三 | 388,659.90     | 0.03%      | 0.16%      | 20,528.10      | 0.01%          | 0.03%          |
|           | 客户二十四 | -              | -          | -          | -              | -              | -              |
| 消费电子行业    | 客户二十五 | 1,770,319.57   | 0.12%      | 0.33%      | 450,682.50     | 0.11%          | 0.17%          |
|           | 客户二十六 | -              | -          | -          | -              | -              | -              |
|           | 客户二十七 | -              | -          | -          | 553,810.62     | 0.14%          | 0.07%          |
| 电源类       | 客户二十八 | 65,113.61      | 0.00%      | 0.02%      | 24,647.79      | 0.01%          | 0.02%          |
|           | 客户四   | 43,939,143.63  | 2.92%      | 1.34%      | 8,739,568.33   | 2.22%          | 2.12%          |
|           | 客户二十九 | 2,845,119.69   | 0.19%      | 0.19%      | 1,224,902.65   | 0.31%          | 0.38%          |
| 安防行业      | 客户三十  | 3,059,950.44   | 0.20%      | 0.53%      | 461,546.18     | 0.12%          | 0.36%          |
|           | 客户三十一 | 584,600.00     | 0.04%      | 0.03%      | -              | -              | -              |
| 大型 EMS 厂商 | 客户三十二 | 19,905,610.57  | 1.32%      | 2.67%      | 3,264,575.91   | 0.83%          | 1.53%          |
|           | 客户三十三 | 3,384,127.01   | 0.23%      | 1.08%      | 553,247.98     | 0.14%          | 0.66%          |
| 合计        |       | 412,781,766.92 | 27.45%     | 28.13%     | 110,917,693.32 | 28.13%         | 24.08%         |

注 1：本公司在客户二十四供应商名录中，最近一年一期尚未交易。

注 2：客户二十六通过代工厂方式进行合作，2025 年及 2026 年 1 季度收入分别是 3,880,539.78 元和 986,159.25 元，2025 年收入占比及 2026 年 1 季度收入占比分别是 0.26% 和 0.25%。

综上所述，公司的客户和行业布局均较为分散，单一客户业绩变动不会对公司整体经营成果产生重大影响。敬请投资者审慎对待，谨防热点概念型炒作，注意投资风险。

**问题 5**

5.请你公司自查并列示公司近期接受媒体采访、机构和投资者调研、回复投资者咨询等情况，说明是否存在违反信息披露公平性原则的情形；并进一步说明公司在上述期间多次开展特定对象调研、路演活动等投资者关系活动的具体考虑、方案设计的具体职能部门，履行的内部程序、审批人员，较此前次数、频率均显著增加的原因及合理性，光模块应用、先进封装领域应用的提问人员。

**【公司回复】**

**1、投资者调研涉及的相关问题**

公司自 2026 年 4 月 25 日至 2026 年 5 月 29 日，共接待并参加了 7 场调研和路演活动，具体情况如下：

| 时间              | 调研形式 | 调研机构及人员                                                                                                                       | 提问人员    | 部分沟通内容                                                                                                                                                       |
|-----------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2026 年 4 月 25 日 | 路演活动 | 天风证券 文毓、朱晔；中银基金 时文博；招商基金 亢思汗；兴业基金 邹慧、刘文婷；太平养老保险 张凯；太平资产 邵军；华泰资产 朱荣华；银河基金 孙啸；融通基金 刘申奥；彤源投资 俞能飞；胤胜资产 李美泽；上海玖时私募基金 翁善根；运舟资本 廖书迪。 | 天风证券 文毓 | 1、请问公司产品在光模块领域是否有应用？有哪些客户？<br>答：在光模块及其部件的生产过程中，锡膏主要应用于三大环节：一是光器件（如TOSA、ROSA）的SMT贴装，二是光芯片封装中的高精度倒装焊（如硅光芯片的微凸点焊接），三是PCBA（印制电路板组件）上其他无源元件的表面贴装。公司的微电子焊接材料等产品可应用 |

|            |      |                                                                                                                                                   |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |      |                                                                                                                                                   |         | <p>于上述应用场景。关于具体客户信息，基于保护客户商业秘密的原则，在符合信息披露监管要求的前提下，公司不单独披露具体客户的业务数据。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2026年4月27日 | 线下调研 | <p>天风证券 文毓；招商证券 李亚明；兴业证券 温佳贝；浙商证券 王龙；国海证券 马嘉艺；融通基金 卢文杰、任涛、王迪、陈甲铨；博普资产 刘世昌；鹏华基金 王天铎；景顺长城基金 林昕阳；大成基金 吴天齐；丹羿投资 宝玥娇；华润元大基金 陈方园；富达国际Luke；中颖投资 戴晶晶。</p> | 浙商证券 王龙 | <p>1、请问公司产品在光模块领域是否有应用？有哪些客户？</p> <p>答：在光模块及其部件的生产过程中，锡膏主要应用于三大环节：一是光器件（如TOSA、ROSA）的SMT贴装，二是光芯片封装中的高精度倒装焊（如硅光芯片的微凸点焊接），三是PCBA（印制电路板组件）上其他无源元件的表面贴装。公司的微电子焊接材料等产品可应用于上述应用场景。关于具体客户信息，基于保护客户商业秘密的原则，在符合信息披露监管要求的前提下，公司不单独披露具体客户的业务数据。</p> <p>2、公司 2025 年研发投入金额及占比如何？研发重点方向与核心技术突破有哪些？</p> <p>答：公司 2025 年度研发费用约 4,009.79 万元，同比上升 21.88%。经过多年深耕细研，公</p> |

|                          |                  |                                               |                                 |                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------------------|------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                          |                  |                                               |                                 | <p>司在超细粒度焊接材料、低温高可靠焊接材料、光伏组件焊接材料、辅助焊接材料及水基清洗剂等关键技术领域实现了突破。</p> <p>公司将持续加大高端微电子焊接材料、半导体封装材料、可靠性材料等领域研发与产品迭代，推进激光锡膏、超细粉锡膏等产品在先进半导体封装等新兴领域的渗透应用，为业务增长提供技术支撑。</p>                                                                           |
| 2026<br>年 4<br>月 28<br>日 | 线<br>下<br>调<br>研 | 长城基金 余欢、杨维维、储雯玉；<br>鹏华基金 王天铎、陈凯睿、周书臣；诺安基金 张曼迪 | 诺<br>安<br>基<br>金<br>张<br>曼<br>迪 | <p>1、请问公司产品在光模块领域是否有应用？有哪些客户？</p> <p>答：在光模块及其部件的生产过程中，锡膏主要应用于三大环节：一是光器件（如TOSA、ROSA）的SMT贴装，二是光芯片封装中的高精度倒装焊（如硅光芯片的微凸点焊接），三是PCBA（印制电路板组件）上其他无源元件的表面贴装。公司的微电子焊接材料等产品可应用于上述应用场景。关于具体客户信息，基于保护客户商业秘密的原则，在符合信息披露监管要求的前提下，公司不单独披露具体客户的业务数据。</p> |
| 2026                     | 路                | 天风证券 文毓；华夏基金 杨雅                               | 宝                               | 1、请问公司产品在光模块领域                                                                                                                                                                                                                          |

|                                            |                                          |                                                                                             |                            |                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 年 5<br>月 7<br>日                            | 演<br>活<br>动<br>及<br>电<br>话<br>会<br>议     | 昭；混沌投资 谭力博；鹏扬基金<br>许颖婕；华福证券 孟鹏飞；宝盈<br>基金 唐叶                                                 | 盈<br>基<br>金<br>唐<br>叶      | 是否有应用？有哪些客户？<br>答：在光模块及其部件的生产过程中，锡膏主要应用于三大环节：一是光器件（如TOSA、ROSA）的SMT贴装，二是光芯片封装中的高精度倒装焊（如硅光芯片的微凸点焊接），三是PCBA（印制电路板组件）上其他无源元件的表面贴装。公司的微电子焊接材料等产品可应用于上述应用场景。关于具体客户信息，基于保护客户商业秘密的原则，在符合信息披露监管要求的前提下，公司不单独披露具体客户的业务数据。 |
| 2026<br>年 05<br>月 14<br>日                  | 202<br>5 年<br>度<br>业<br>绩<br>说<br>明<br>会 | 线上参与公司 2025 年度业绩说明会的投资者                                                                     | -                          | -                                                                                                                                                                                                              |
| 2026<br>年 05<br>月 19<br>日、<br>2026<br>年 05 | 线<br>下<br>调<br>研                         | 光大证券 黄帅斌；中信建投 覃静、汪洁；华西证券 石城；招商证券 朱艺晴；平安基金 黄维；广发证券 牛璐、汪家豪；长城基金 陈子扬；方正证券 赵璐；鑫元基金 张咏；诺德基金 杨雅荃； | 光<br>大<br>证<br>券<br>黄<br>帅 | 1、请问公司的产品可以用于先进封装吗？<br>答：公司生产的微电子焊接材料作为电子材料行业的重要基础材料之一，主要应用于PCBA制程、精密结构件连接、半导体封                                                                                                                                |

|                           |                  |                                                                                                                         |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 月 20<br>日                 |                  | 诺安基金 黄友文；沅京资本 景戎鑫；复胜资产 孙人杰；南土资产 王可；瓦洛兰 董骁；红土创新基金 郑伟佳；信诚基金 陆亚兵；德之宝投资 武建邺、贲友梅；泰康基金 周妍；信达澳银 杨珂；安信基金 倪瑞超；国金证券 李阳、赵铭、王后爱、罗琴。 | 斌；<br>华<br>西<br>证<br>券<br>石<br>城 | <p>装等多个产业环节的电子器件的组装与互联。公司将持续加大高端微电子焊接材料、半导体封装材料、可靠性材料等领域研发与产品迭代，推进激光锡膏、超细粉锡膏等产品在先进半导体封装等新兴领域的渗透应用，为业务增长提供技术支撑。</p> <p>2、请问公司产品在光模块领域是否有应用？有哪些客户？</p> <p>答：在光模块及其部件的生产过程中，锡膏主要应用于三大环节：一是光器件（如TOSA、ROSA）的SMT贴装，二是光芯片封装中的高精度倒装焊（如硅光芯片的微凸点焊接），三是PCBA（印制电路板组件）上其他无源元件的表面贴装。公司的微电子焊接材料等产品可应用于上述应用场景。关于具体客户信息，基于保护客户商业秘密的原则，在符合信息披露监管要求的前提下，公司不单独披露具体客户的业务数据。</p> |
| 2026<br>年 05<br>月 21<br>日 | 线<br>下<br>调<br>研 | 西南证券 胡光怿、戚欣龙；银河基金 傅鑫、金烨；西部证券 郭义俊；浙商证券 张致远                                                                               | 西<br>部<br>证<br>券<br>郭            | <p>1、请问公司的产品可以用于先进封装吗？</p> <p>答：公司生产的微电子焊接材料作为电子材料行业的重要基础材料之一，主要应用于PCBA制</p>                                                                                                                                                                                                                                                                               |

|  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  | <p>义俊</p> <p>程、精密结构件连接、半导体封装等多个产业环节的电子器件的组装与互联。公司将持续加大高端微电子焊接材料、半导体封装材料、可靠性材料等领域研发与产品迭代，推进激光锡膏、超细粉锡膏等产品在先进半导体封装等新兴领域的渗透应用，为业务增长提供技术支撑。</p> <p>2、请问公司产品在光模块领域是否有应用？有哪些客户？</p> <p>答：在光模块及其部件的生产过程中，锡膏主要应用于三大环节：一是光器件（如TOSA、ROSA）的SMT贴装，二是光芯片封装中的高精度倒装焊（如硅光芯片的微凸点焊接），三是PCBA（印制电路板组件）上其他无源元件的表面贴装。公司的微电子焊接材料等产品可应用于上述应用场景。关于具体客户信息，基于保护客户商业秘密的原则，在符合信息披露监管要求的前提下，公司不单独披露具体客户的业务数据。</p> |
|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

以上信息详见披露在巨潮资讯网上的投资者关系活动记录表（<http://www.cninfo.com.cn/>）。

## 2、公司董事、高级管理人员及核心技术人员在外接受采访涉及的相关信息

| 采访日期            | 采访地点       | 采访媒体  | 采访对象           | 具体内容                                                                                       |
|-----------------|------------|-------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2026 年 5 月 27 日 | 中国锡业年会（深圳） | 央视财经网 | 公司职工董事、研发总监资春芳 | 记者：高端锡料国产化提速，您对当前市场发展的看法？                                                                  |
|                 |            |       |                | 资春芳：对于半导体行业的新兴需求，对整个产品性能的要求更高，对于我们以锡膏为代表技术含量比较高的焊料，国内（高端化）企业占比不到 50%，真正要做到国产替代，才是未来发展的大方向。 |

本次媒体采访以行业发展情况为主，未针对公司经营情况做相关提问与表述。

### 3、公司近年来接待投资者调研情况如下：

| 年份           | 投资者接待次数（次） |
|--------------|------------|
| 2026 年 1-5 月 | 7          |
| 2025 年       | 9          |
| 2024 年       | 9          |
| 2023 年       | 12         |

近年来，公司接待投资者调研次数平均保持在每年 10 次左右，整体处于稳定水平。今年上半年接待调研次数较往年有所增加，主要系：

（1）2025 年度公司实现营业收入 15.04 亿元，同比增长 24.07%；2026 年第一季度公司实现营业收入 3.94 亿元，同比增长 27.44%，扣非净利润 2,864.84 万元，同比增长 46.24%。公司在 2026 年 4 月 22 日披露年报及一季报后，因报告营收实现增长，市场关注度同步提升，多家机构投资者、证券分析师基于对公司经营基本面的关注，主动提出实地走访、现场调研、交流、路演的需求且较以往增加，致使公司当期调研接待次数相应增加；公司依规常态化开展投资者接待工作，未主动邀约机构进行调研。公司严格按照公司《投资者关系管理制度》及深交所信息披露相关规则组织了 7 次集中调研接待，调研结束后及时披露了《投资者关系活动记录表》。

（2）受 4 月光模块、先进封装设备行业市场热点带动，机构投资者、证券分析师在投资者交流活动中有向公司主动提出相关问题，公司就自身相关产品应

用情况予以回复，交流内容属于公司产品应用和技术属性，均有公开资料可查，未预先设定提问方向、策划问题内容，不存在主动引导调研提问的情形。

（3）根据以往年度来看，每年年报披露之后到第三季度通常为机构调研高峰期，活动频率较其他时段有所增加属于市场普遍情况。

综上所述，活动频率的增加具有合理性，不存在为配合特定事项而人为集中安排的情形。公司根据《上市公司投资者关系管理工作指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》，积极落实投资者关系管理要求、回应市场关切、提升信息透明度，调研内容均未涉及未披露的公开信息，不存在选择性披露、内幕信息泄露及不当市值管理等情形，不存在违反信息披露公平性原则的情形。

（4）公司展开投资者调研的考虑、内部程序等情况

公司投资者关系活动实行董事会办公室统筹、多部门协同的管理机制。董事会办公室作为牵头部门，负责活动具体安排；必要时，研发部门参会并提供相关技术问题支持。

前述期间内，所有投资者关系活动均履行完整、规范的内部审批流程，由董事会办公室编制信披文件，会稿经所涉及的相关部门审核，由证券事务代表撰写、董事会秘书审核，最终报董事长审批同意后披露。

## 问题 6

6.请你公司说明近期经营情况及内外部环境是否发生重大变化，核实是否存在筹划中的重大事项，是否存在其他应披露未披露信息，是否存在其他对公司股票交易价格可能产生较大影响的市场传闻、热点概念等，前期信息披露是否存在需补充或更正情形。

### 【公司回复】

#### 1、公司内部经营环境情况

公司近期内部生产经营情况正常，未发生重大变化。

#### 2、公司外部经营环境情况

除下列情况外，近期公司外部经营环境未发生重大变化。

公司主要经营微电子焊接材料，生产所需主要原材料为锡锭、锡合金粉等，前述原材料成本占主营业务成本比重较高。其中，锡锭价格主要受国际国内锡金属市场行情影响，锡合金粉价格受锡、银等贵金属价格共同驱动。根据上海有色金属网数据，2025 年 1 月至 2026 年 6 月 4 日锡价格的变动情况如下：



数据来源：上海有色金属网

由上图可知，锡价自 2025 年初至今由 24.45 万元/吨涨至 44.25 万元/吨，增长 80.98%。此外，据央视财经官方媒体报道：“随着人工智能产业的快速发展，锡作为算力金属，其价格出现明显上涨，从去年 11 月的每吨 30 万元，涨至目前的每吨 42 万元左右，半年上涨 40%。” 相关报道备受市场关注。

除上述情况外，公司近期经营情况及内外部环境未发生重大变化。

3、经公司自查并经相关人员出具的承诺函，公司目前不存在筹划中的重大事项，也不存在其他应披露而未披露信息。

经公司自查，除光模块、先进封装、算力金属热点因素外，未发现存在其他对公司股票交易价格可能产生重大影响的市场传闻、热点概念等，不存在需要补充或更正公告的情形。

#### **问题 7**

**7.你公司认为应予说明的其他事项。**

#### **【公司回复】**

基于商业秘密和商业敏感信息，根据相关法律法规、规范性文件和公司《信息披露暂缓与豁免事务管理制度》，公司对本次关注函回复中关于客户名称事项进行豁免披露处理。

特此公告。

**深圳市唯特偶新材料股份有限公司董事会**

**2026 年 6 月 7 日**